



主要特点

反射式设计

插入损耗: 1.5 dB

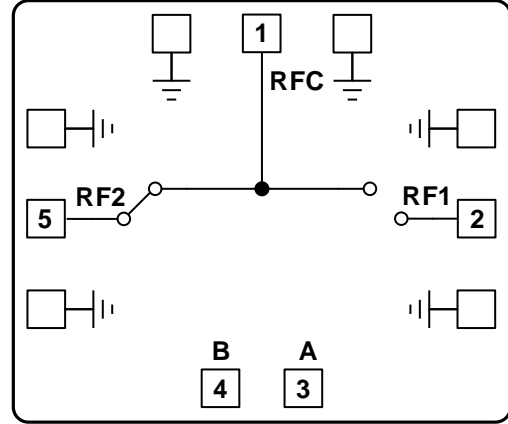
隔离度: 40 dB

输入 P-1: +39 dBm

耐功率: 10 W

芯片尺寸: 1.25 x 1.11 x 0.1 mm³

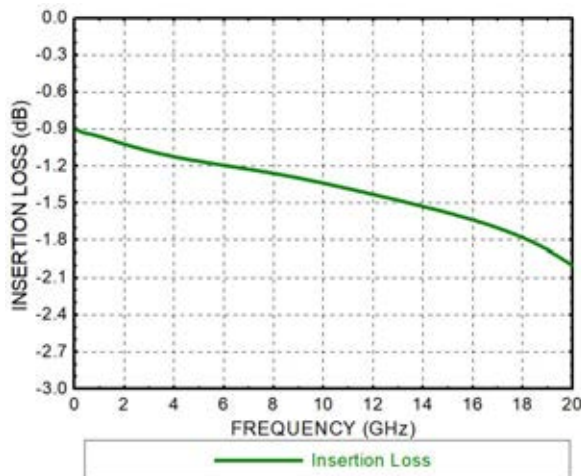
功能框图



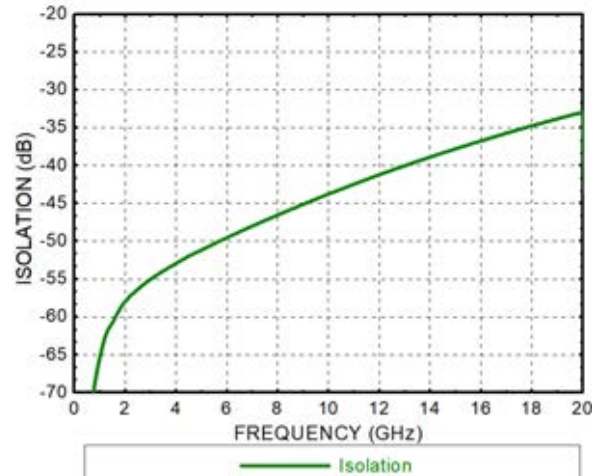
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_{CTL} = 0/-5\text{ V}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	DC - 18			GHz
插入损耗		1.5		dB
隔离度		40		dB
回波损耗“打开状态”		15		dB
输入功率 1dB 压缩点@1-18GHz		39		dBm
最大输入功率		40		dBm
开关切换时间		50		ns

插入损耗

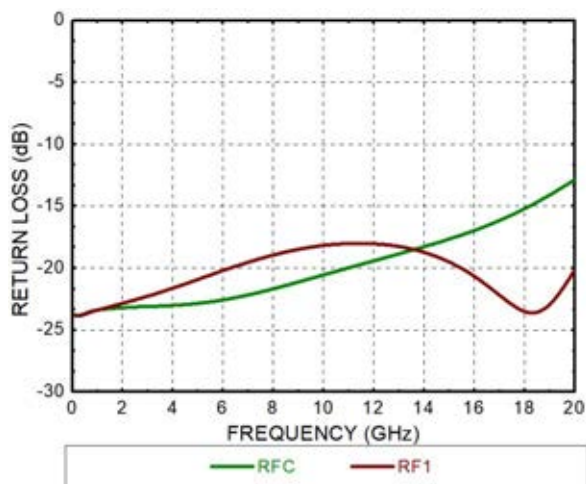


隔离度

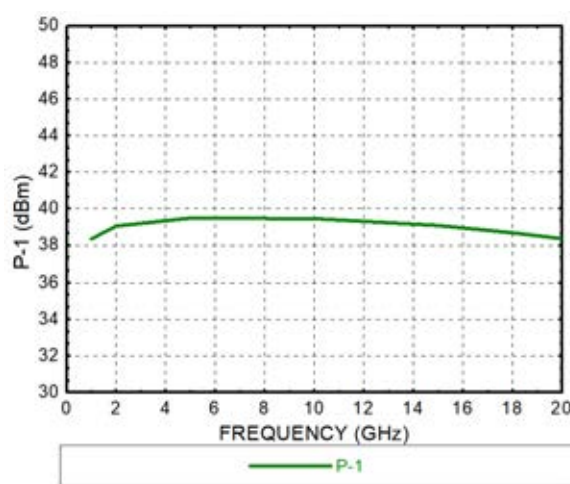




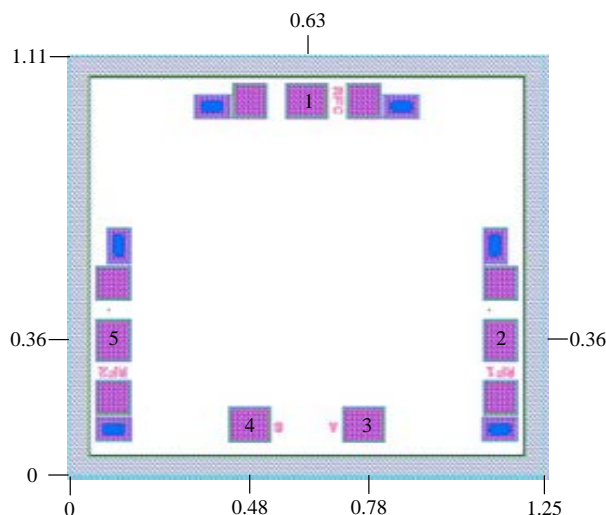
回波损耗, “ON” 状态



输入功率 P_{-1}



物理参数



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	RFC	该焊盘是 DC 耦合并匹配至 50 Ohm。如果 RF 电位不是 0V, 那么需要外部加入隔直电容
2, 5	RF1, RF2	该焊盘是 DC 耦合并匹配至 50 Ohm。如果 RF 电位不是 0V, 那么需要外部加入隔直电容
3, 4	A, B	A=-5V, B=0V, 则 RF1 为 “ON” 状态, RF2 为 “OFF” 状态; A=0V, B=-5V, 则 RF1 为 “OFF” 状态, RF2 为 “ON” 状态
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

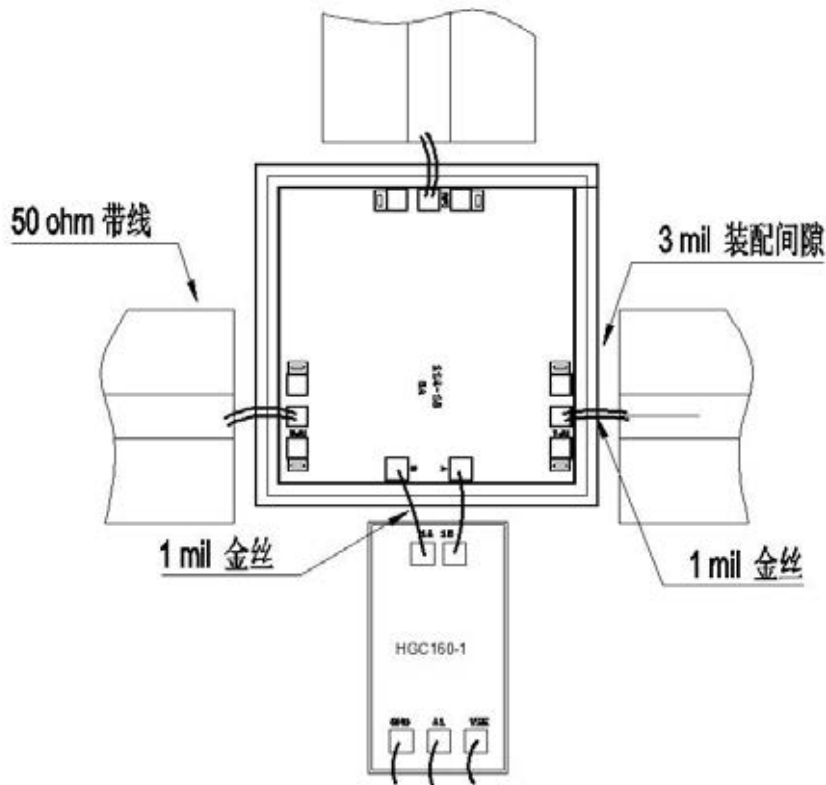


真值表

功能	A	B
RFC-RF1	1	0
RFC-RF2	0	1

“0”电平范围：0~-0.2V，“1”电平范围：-3~-6V。

推荐装配图



注意事项

1. 芯片厚度为 100 μm
2. 典型键合焊盘尺寸为 $100 \times 100 \mu\text{m}^2$
3. 键合焊盘金属化：金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 未标注的键合焊盘不需要连接

极限参数

1. 射频输入功率：+40 dBm
2. 储存温度：-65 ~ +175 $^{\circ}\text{C}$
3. 工作温度：-55 ~ +85 $^{\circ}\text{C}$